# 电子系统设计基础

班级:信息 005 学号: 2206113602 姓名:王靳朝

# 实验三: 直流稳压电源的 PCB 设计

#### 一、实验内容(10分)

使用 AD 软件完成直流稳压电源的原理图和 PCB 绘制,注意布线规则和电气规则。

#### 二、实验原理(40分)

#### 2.1 AltiumDesigner 的基本使用

AD2021 是一款功能强大的 PCB 绘制软件, 其基本使用流程如下:

首先在 AD 软件中新建工程文档,一定为全英文路经否则有可能无法识别,在工程文件夹中添加原理图和 PCB 文件。其次根据 multisim 软件的仿真电路在原理图文件中绘制原理图,注意选择每个元器件的封装。封装的选择应当根据实验室实际有的元器件进行考虑。在检查完原理图无误后,将原理图更新至 PCB 文件,调整各元件的位置,调整线宽等规则,并进行布线。绘制完成后对 PCB 进行裁剪、铺铜、打上下通孔,最后进行电器规则检查,无误后可以利用硫酸纸打印,从而印制电路板。

### 2.2 布局布线的考虑

PCB 布线有以下几点考虑:

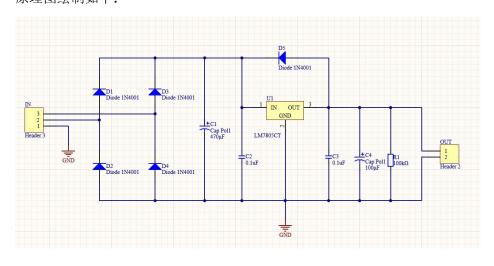
1.线宽。通过大电流的线宽应当较宽,例如和直流电源、信号源相连的先线宽可以设置为 30mil,其余信号线可以设置为 20mil 首选,最大 40mil。

2.线之间和线与元器件之间的夹角。由于在高频部分直角会出现电磁干扰,因此在绘制 PCB 时应尽量将线与线、线与元器件之间的夹角设置为钝角,是在无法避免可以设置为直角,但最好避免锐角出现。

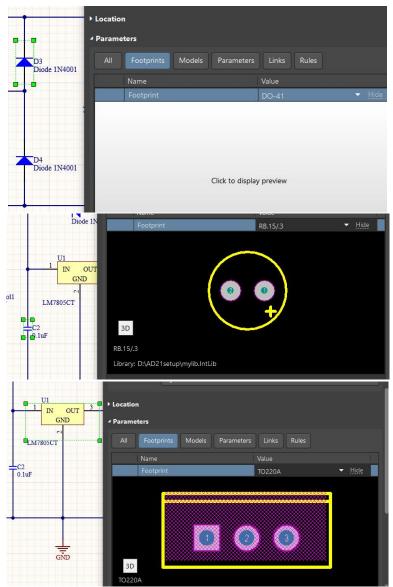
3.尽量不要出现大量的平行布线。在高频部分,平行布线会出现增加的特性阻抗,从而极大的影响 PCB 高频性能。

#### 三、实验过程(40分)

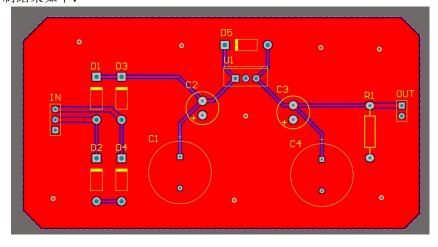
3.1 原理图的绘制 原理图绘制如下:

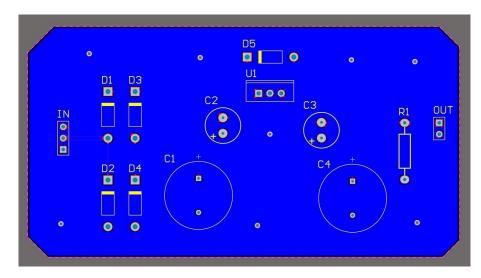


实验室中有直插式电阻、电容、二极管和芯片,因此绘制完原理图后将封装全部设置为直插式。



3.2 PCB 的绘制 PCB 绘制结果如下:





# 并作电器规则检查:

| Rule Violations  | Count   |
|--|---------|
| Clearance Constraint (Gap=10mil).(All).(All)   | 0       |
| Short-Circuit Constraint (Allowed=No). (All). (All)  | 0       |
| Un-Routed Net Constraint.(.(All).)   | 0       |
| Modified Polygon (Allow modified: No), (Allow shelved: No)   | 0       |
| Width Constraint (Min=10mil) (Max=40mil) (Preferred=20mil) (All)   | 0       |
| Power Plane Connect Rule(Relief Connect.)(Expansion=20mil).(Conductor Width=10mil).(Air Gap=10mil).(Entries=4).(All) | 0       |
| Hole Size Constraint (Min=1mil) (Max=100mil) (All)   | 0       |
| Hole To Hole Clearance (Gap=10mil) (All),(All)   | 0       |
| Minimum_Solder_Mask_Sliver_(Gap=10mil)_(All).(All)   | 0       |
| Silk To Solder Mask (Clearance=10mil) (IsPad).(All)  | 2       |
| Silk to_Silk (Clearance=10mil)_(All),(All)   | 0       |
| Net Antennae (Tolerance=0mil).(All)  | 0       |
| Height Constraint (Min=0mil) (Max=1000mil) (Prefered=500mil) (All)   | 0       |
|  | Total 2 |

有两个焊盘内部的间距问题,并不影响 PCB 绘制和电路板使用。

# 四、总结(10分)

- 1. 原理图绘制尽可能条理清晰,元器件的功能和位置明确,并且一定确保元器件的封装实验室内存有相关器件。
- 2. PCB 绘制时可以掌握相关快捷键以加快效率,例如 Ctrl+W 可以快速布线。
- 3. 确保上下层的连接。地信号的稳定极大的影响电路性能稳定,因此可以多打几个通孔增强地信号的连接。
- 4. 布线时,整齐好看往往意味着性能优越。
- 5. 对付复杂电路,会出现双层板乃至多层板的绘制,需要打额外的上下通孔,但两面的连接规则、方法是相同的。
- 6. 对于被元器件围起来的铜或者芯片引脚之间的铜,我们一般称为死铜。死铜的存在会给后续焊接带来隐患。因此绘制完之后我们有必要进行去除死铜的处理。双击板面可以修改去除死铜的规则,也可以 place 栏里选择 polygon pour cutout 进行手动去除。去除后重新普通即可。规则修改如下:

